

2022-2028年中国晶圆加工设备行业市场调查研究 及投资策略研究报告

报告大纲

智研咨询

www.chyxx.com

一、报告简介

智研咨询发布的《2022-2028年中国晶圆加工设备行业市场调查研究及投资策略研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/1103023.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

智研咨询发布的《2022-2028年中国晶圆加工设备行业市场调查研究及投资策略研究报告》共十三章。首先介绍了晶圆加工设备行业市场发展环境、晶圆加工设备整体运行态势等，接着分析了晶圆加工设备行业市场运行的现状，然后介绍了晶圆加工设备市场竞争格局。随后，报告对晶圆加工设备做了重点企业经营状况分析，最后分析了晶圆加工设备行业发展趋势与投资预测。您若想对晶圆加工设备产业有个系统的了解或者想投资晶圆加工设备行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 2017-2021年中国晶圆加工设备行业发展环境分析

1.1 政策环境

1.1.1 行业政策概览

1.1.2 行业规划政策

1.1.3 行业税收政策

1.2 经济环境

1.2.1 全球经济形势

1.2.2 国内经济运行

1.2.3 对外经济分析

1.2.4 工业经济运行

1.2.5 固定资产投资

1.2.6 宏观经济展望

1.3 行业环境

1.3.1 半导体行业产业链

1.3.2 全球半导体行业发展情况

1.3.3 全球半导体产业转移阶段

1.3.4 全球半导体行业资本开支

1.3.5 中国半导体行业发展情况

1.3.6 半导体行业发展趋势

第二章 2017-2021年中国晶圆加工设备行业发展综述

2.1 晶圆加工设备概述

2.1.1 晶圆加工设备分类

- 2.1.2 晶圆加工设备特点
- 2.1.3 行业的上下游情况
- 2.1.4 晶圆加工设备价值
- 2.2 半导体设备行业发展情况
 - 2.2.1 半导体设备行业基本情况
 - 2.2.2 全球半导体设备行业发展情况
 - 2.2.3 国内半导体设备行业政策分析
 - 2.2.4 中国半导体设备行业发展情况
 - 2.2.5 国内半导体设备行业发展需求
- 2.3 晶圆加工设备行业发展情况
 - 2.3.1 全球晶圆加工设备市场规模
 - 2.3.2 中国晶圆加工设备市场规模
 - 2.3.3 中国集成电路制造设备国产化潜力
- 2.4 中国晶圆加工设备行业投招标情况
 - 2.4.1 半导体设备行业招投标情况
 - 2.4.2 晶圆加工设备厂商中标现状
 - 2.4.3 晶圆加工设备厂商中标动态
 - 2.4.4 晶圆加工设备行业投资风险
- 2.5 晶圆加工设备行业发展挑战及建议
 - 2.5.1 晶圆加工设备行业发展挑战
 - 2.5.2 晶圆加工设备行业发展建议
- 第三章 2017-2021年中国光刻设备行业发展综述
 - 3.1 光刻设备概述
 - 3.1.1 光刻机基本介绍
 - 3.1.2 光刻技术介绍
 - 3.1.3 EUV光刻机制造工艺
 - 3.1.4 主流光刻机产品对比
 - 3.2 全球光刻设备行业发展情况分析
 - 3.2.1 全球光刻机发展历程
 - 3.2.2 全球光刻机行业销量规模
 - 3.2.3 全球光刻机行业市场规模
 - 3.2.4 全球光刻机产品结构分析
 - 3.2.5 全球光刻机行业竞争格局
 - 3.3 中国光刻设备行业发展情况分析
 - 3.3.1 国内光刻机产业链布局

3.3.2 国内光刻机研发动态

3.3.3 国产光刻机发展建议

第四章 2017-2021年中国薄膜沉积设备行业发展综述

4.1 薄膜沉积设备概述

4.1.1 薄膜沉积设备定义

4.1.2 薄膜沉积设备分类

4.2 薄膜沉积设备市场发展情况

4.2.1 全球薄膜沉积设备市场规模

4.2.2 全球薄膜沉积设备竞争态势

4.2.3 国内薄膜沉积设备招标情况

4.2.4 国内薄膜沉积设备竞争态势

4.2.5 薄膜沉积设备行业面临挑战

4.3 化学气相沉积（CVD）设备行业发展情况

4.3.1 CVD技术概述

4.3.2 CVD设备产业链全景

4.3.3 CVD设备行业发展现状

4.3.4 CVD设备行业竞争格局

4.4 薄膜沉积设备行业发展前景

4.4.1 薄膜沉积设备行业面临机遇

4.4.2 薄膜沉积设备行业风险分析

4.4.3 薄膜沉积设备行业发展趋势

第五章 2017-2021年中国刻蚀设备行业发展综述

5.1 刻蚀设备概述

5.1.1 半导体刻蚀技术

5.1.2 刻蚀工艺分类

5.1.3 刻蚀先进工艺

5.1.4 刻蚀设备原理

5.1.5 刻蚀设备分类

5.1.6 刻蚀设备产业链

5.2 全球刻蚀设备行业发展情况

5.2.1 刻蚀设备市场规模

5.2.2 刻蚀设备市场结构

5.2.3 刻蚀设备竞争格局

5.3 中国刻蚀设备行业发展情况

5.3.1 刻蚀行业驱动因素

5.3.2 刻蚀设备国产化情况

5.3.3 刻蚀技术水平发展状况

5.3.4 刻蚀领域技术水平差距

5.3.5 刻蚀设备国产替代机遇

第六章 2017-2021年中国化学机械抛光设备行业发展状况

6.1 CMP设备概述

1.1.1 CMP技术概念

6.1.1 CMP设备应用场景

1.1.2 CMP设备基本类型

6.2 全球CMP设备行业发展情况

6.2.1 全球CMP设备市场分布

6.2.2 全球CMP设备竞争格局

6.2.3 全球CMP设备市场规模

6.3 中国CMP设备行业发展情况

6.3.1 CMP设备市场规模

6.3.2 CMP设备市场分布

6.3.3 CMP设备市场集中度

6.3.4 CMP设备行业面临挑战

6.3.5 CMP设备行业投资风险

6.3.6 CMP设备技术发展趋势

第七章 2017-2021年中国清洗设备行业发展综述

7.1 清洗设备行业概述

7.1.1 半导体清洗介绍

7.1.2 半导体清洗工艺

7.1.3 清洗设备的主要类型

7.1.4 清洗设备的清洗原理

7.2 全球清洗设备行业发展情况

7.2.1 全球清洗设备行业市场规模

7.2.2 全球清洗设备行业竞争格局

7.2.3 全球清洗设备公司技术布局

7.2.4 全球清洗设备市场结构分布

7.3 中国清洗设备行业发展情况

7.3.1 国内清洗设备企业发展情况

7.3.2 国内清洗设备行业技术发展

7.3.3 国内清洗设备厂商中标情况

7.3.4 国内清洗设备市场发展空间

第八章 2017-2021年中国离子注入设备行业发展综述

8.1 离子注入机概述

8.1.1 离子注入工艺

8.1.2 离子注入机组成

8.1.3 离子注入机类型

8.1.4 离子注入机工作原理

8.2 离子注入机应用领域分析

8.2.1 光伏应用领域

8.2.2 集成电路应用领域

8.2.3 面板AMOLED领域

8.3 全球离子注入设备发展状况

8.3.1 行业市场价值

8.3.2 全球市场规模

8.3.3 全球市场格局

8.3.4 行业进入壁垒

8.4 国内离子注入设备行业发展情况

8.4.1 行业相关政策

8.4.2 行业供求分析

8.4.3 行业市场规模

8.4.4 细分市场分析

8.4.5 市场竞争格局

8.4.6 行业发展趋势

第九章 2017-2021年晶圆加工设备行业下游发展分析——晶圆制造行业

9.1 晶圆制造行业概述

9.1.1 行业发展历程

9.1.2 企业经营模式

9.1.3 行业技术发展

9.2 全球晶圆制造业发展分析

9.2.1 全球集成电路产业态势

9.2.2 全球集成电路市场规模

9.2.3 全球集成电路市场份额

9.2.4 全球晶圆制造产能分析

9.3 中国晶圆制造业发展分析

9.3.1 晶圆制造行业规模

9.3.2 晶圆制造行业产量

9.3.3 晶圆制造区域发展

9.3.4 晶圆制造并购分析

9.3.5 芯片制程升级需求

9.3.6 晶圆制造发展机遇

9.4 晶圆代工业市场运行分析

9.4.1 全球晶圆代工市场份额

9.4.2 全球晶圆代工企业扩产

9.4.3 全球专属晶圆代工厂排名

9.4.4 国内本土晶圆代工公司排名

9.4.5 晶圆代工市场发展预测

第十章 国外晶圆加工设备主要企业经营情况

10.1 应用材料（AMAT）

10.2 泛林半导体（Lam）

10.3 东京电子（TEL）

10.4 先晶半导体（ASMI）

第十一章 国内晶圆加工设备主要企业经营情况

11.1 拓荆科技

11.1.1 企业发展概况

11.1.2 经营效益分析

11.1.3 业务经营分析

11.1.4 财务状况分析

11.1.5 核心竞争力分析

11.1.6 公司发展战略

11.2 北方华创

11.2.1 企业发展概况

11.2.2 经营效益分析

11.2.3 业务经营分析

11.2.4 财务状况分析

11.2.5 核心竞争力分析

11.2.6 公司发展战略

11.3 中微公司

11.3.1 企业发展概况

11.3.2 经营效益分析

11.3.3 业务经营分析

- 11.3.4 财务状况分析
- 11.3.5 核心竞争力分析
- 11.3.6 公司发展战略
- 11.4 盛美上海
 - 11.4.1 企业发展概况
 - 11.4.2 企业主营产品
 - 11.4.3 经营效益分析
 - 11.4.4 业务经营分析
 - 11.4.5 财务状况分析
 - 11.4.6 核心竞争力分析
- 11.5 至纯科技
 - 11.5.1 企业发展概况
 - 11.5.2 企业主要业务
 - 11.5.3 经营效益分析
 - 11.5.4 业务经营分析
 - 11.5.5 财务状况分析
 - 11.5.6 核心竞争力分析
- 11.6 万业企业
 - 11.6.1 企业发展概况
 - 11.6.2 经营效益分析
 - 11.6.3 业务经营分析
 - 11.6.4 财务状况分析
 - 11.6.5 核心竞争力分析
 - 11.6.6 公司发展战略
- 11.7 屹唐股份
 - 11.7.1 企业发展概况
 - 11.7.2 经营效益分析
 - 11.7.3 业务经营分析
 - 11.7.4 财务状况分析
 - 11.7.5 核心竞争力分析
 - 11.7.6 公司发展战略
- 11.8 华海清科
 - 11.8.1 企业发展概况
 - 11.8.2 抛光垫产品发展
 - 11.8.3 经营效益分析

11.8.4 业务经营分析

11.8.5 财务状况分析

11.8.6 核心竞争力分析

第十二章 中国晶圆加工设备行业项目投资案例

12.1 拓荆科技原子层沉积（ALD）设备研发与产业化项目

12.1.1 项目基本情况

12.1.2 项目投资概算

12.1.3 项目进度安排

12.1.4 项目效益分析

12.2 盛美上海清洗设备研发项目

12.2.1 项目基本情况

12.2.2 项目价值分析

12.2.3 项目投资概算

12.2.4 项目效益分析

12.3 屹唐股份刻蚀设备研发项目

12.3.1 项目基本情况

12.3.2 项目进度安排

12.3.3 项目价值分析

12.3.4 项目效益分析

12.4 华海清科化学机械抛光设备项目投资案例

12.4.1 项目基本情况

12.4.2 项目投资价值

12.4.3 项目投资概算

12.4.4 项目效益分析

第十三章 2022-2028年晶圆加工设备行业发展前景及趋势预测

13.1 晶圆加工设备行业发展前景

13.1.1 行业面临机遇

13.1.2 国产替代前景

13.1.3 下游市场趋势

13.2 2022-2028年中国晶圆加工设备行业预测分析

13.2.1 2022-2028年中国晶圆加工设备行业影响因素分析

13.2.2 2022-2028年中国晶圆加工设备市场规模预测（ZY ZS）

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/1103023.html>